

产品概述

华彩威新一代数字LED专为高清图像显示应用开发，端口刷新频率高达10kHz，每个通道高达16bit灰度数据，以及内部4bit gamma 校验，可达20bit显示效果。

高度集成的数字LED外部不需要包括电容在内的任何电子元件；

双路输入输出信号，自动切换，确保可靠性；

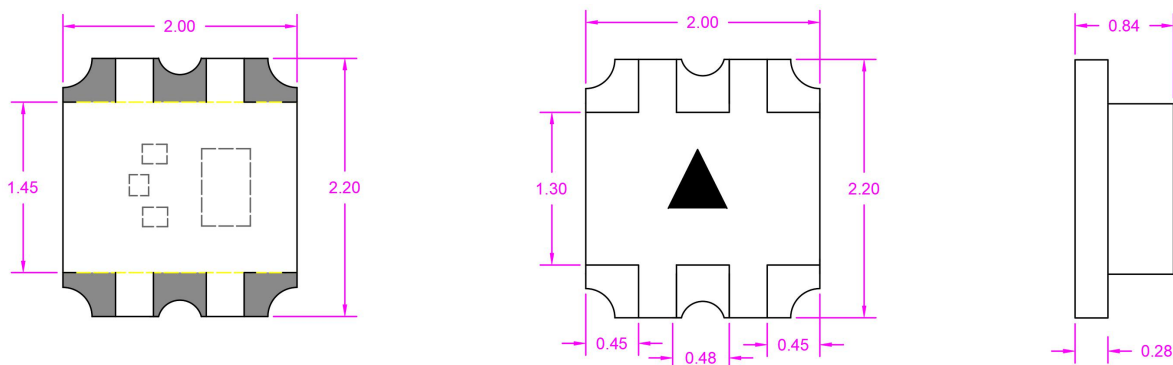
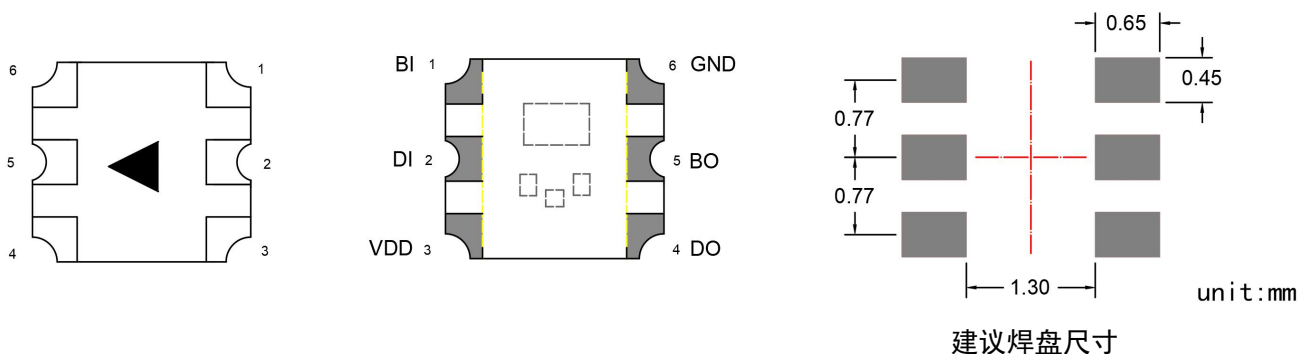
数据协议采用单线归零码的通讯方式，像素点在上电复位以后，DIN端接受从控制器传输过来的数据，首先送过来的48bit数据被第一个像素点提取后，送到像素点内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少48bit。像素点采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制，仅仅受限信号传输速度要求。

主要特点

- IC控制电路与LED点光源共用一个电源。
- 控制电路与RGB芯片集成在一个2020封装的元器件中，构成一个完整的外控像素点。
- 内置信号整形电路，任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线路波形畸变不会累加。
- 内置上电复位和掉电复位电路。
- OUT R/G/B 输出灰度等级：65536级（内置4Bit GAMMA校正）。
- 端口扫描频率10KHz。
- 串行级联接口，能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
- 2.2mm*2.0mm*0.84mm超小尺寸。

主要应用领域

- LED透明显示屏
- LED像素屏
- LED异形屏

机械尺寸 (单位mm)

引出端排列

引脚功能

引脚位	符号	管脚名	功能描述
1	BI	辅助信号输入	辅助信号输入引脚
2	DI	主路信号输入	主路信号输入引脚
3	VDD	电源	供电引脚
4	DO	主路信号输出	控制信号输出引脚
5	BO	辅助信号输出	辅助信号输出引脚
6	GND	地	信号接地和电源接地引脚

最大额定值 (T_A=25°C, V_{SS}=0V)

参数	符号	范围	单位
电源电压	V _{DD}	+3.3~+5.5	V
逻辑输入电压	V _I	-0.3V~V _{DD} +0.7	V
静态电流	I _{DD}	<0.8	mA
工作温度	T _{opt}	-40~+65	°C
储存温度	T _{stg}	-40~+85	°C

电气参数 (T_A=25°C, V_{DD}=5V, V_{SS}=0V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
端口输出电流	I _{out}	—	20	—	mA	OUTR+OUTG+OUTB
输入电流	I _I	—	—	±1	μA	V _I =V _{DD} /V _{SS}
高电平输入电压	V _{IH}	0.7V _{DD}	—	—	V	
低电平输入电压	V _{IL}	—	—	0.3 V _{DD}	V	
滞后电压	V _H	—	0.35	—	V	
动态电流功耗	IDD _{dyn}	—	0.7	1	mA	OUTR,OUTG,OUTB =OFF DO=开路
消耗功率	PD	—	—	250	mW	T _a =25°C
信号输出灌电流	I _{odo}	—	—	45	mA	

开关特性 (T_A=25°C, V_{DD}=5V, V_{SS}=0V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
传输延迟时间	t _{PLZ}	—	—	300	ns	CL=15pF, DIN→DOOUT, RL=10KΩ
下降时间	t _{THZ}	—	—	120	μs	CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB
输入电容	C _I	—	—	15	pF	—

LED 特性参数

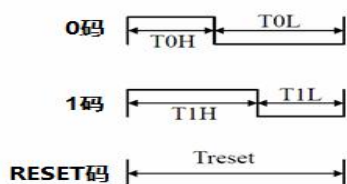
参数	符号	颜色	测试条件: V _{DD} =5V			
			最小值	典型值	最大值	单位
发光强度	IV	Red	210	285	360	mcd
		Green	400	520	650	
		Blue	70	90	120	
波长	λ _d	Red	620	623	625	nm
		Green	522	525	527	
		Blue	467	469	472	
色坐标	CIE	-	0.30	-	/	
		-	0.33	-	/	
发光角度	θ _{1/2}	-	120	-	Deg	

数据传输时间

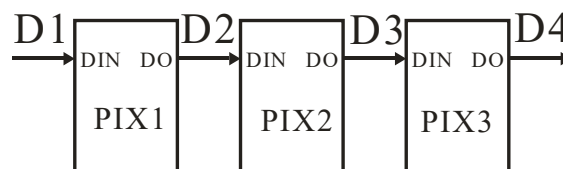
T0H	0 码, 高电平时间	200ns~320ns
T1H	1 码, 高电平时间	520ns~800ns
T0L	0 码, 低电平时间	800ns~1.2μs
T1L	1 码, 低电平时间	480ns~1μs
RES	帧单位, 低电平时间	280μs 以上
数据周期: $T0H+T0L \geq 1.25\mu s$; $T1H+T1L \geq 1.25\mu s$		

时序波形图

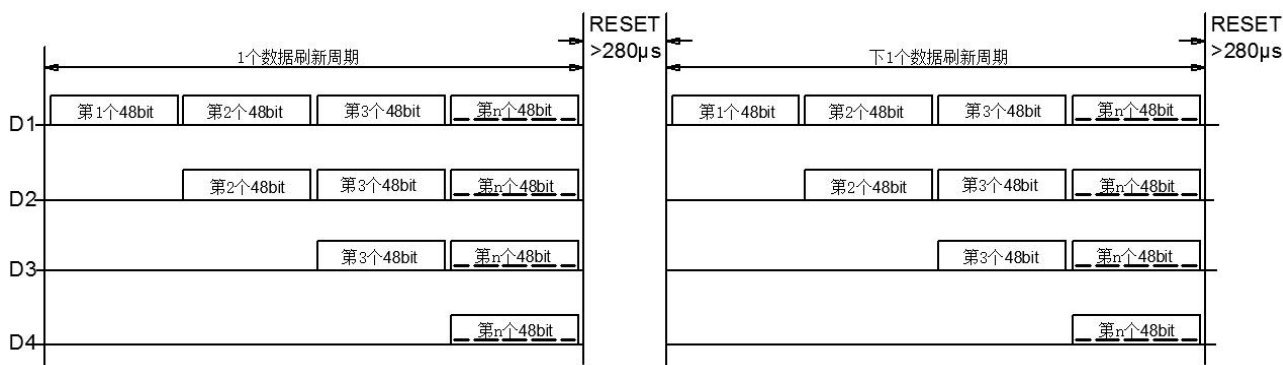
输入码型:



连接方法:

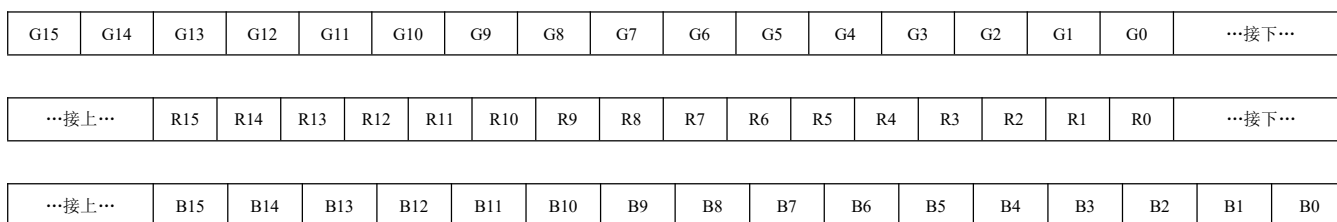


数据传输方法



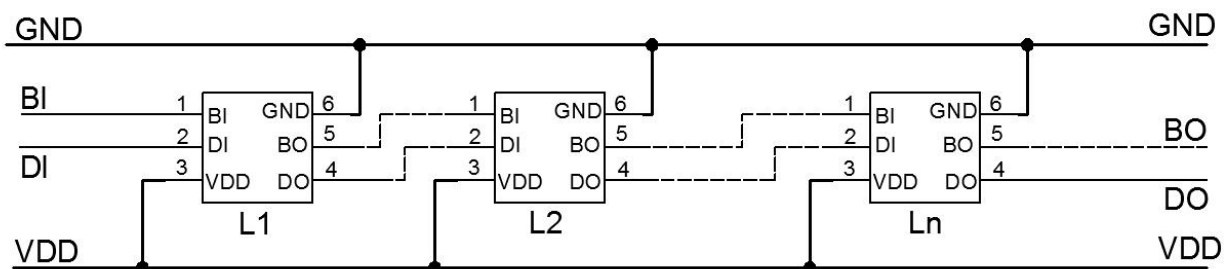
注: 其中 D1 为 MCU 端发送的数据, D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

48bit 数据结构



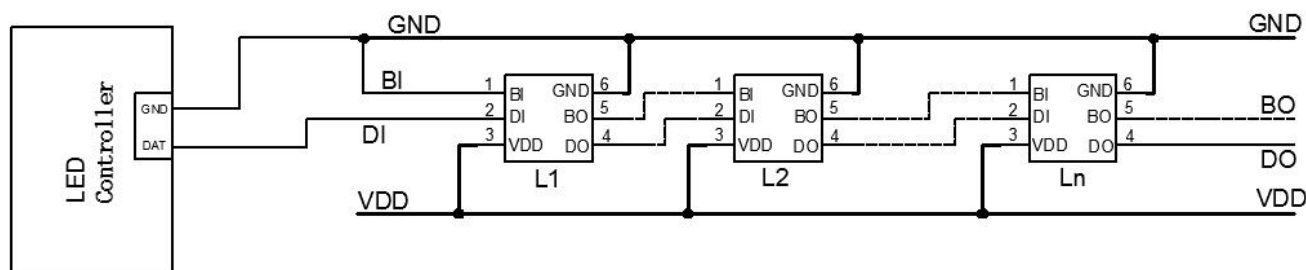
注: 高位先发, 按照 GRB 的顺序发送数据。

典型应用电路

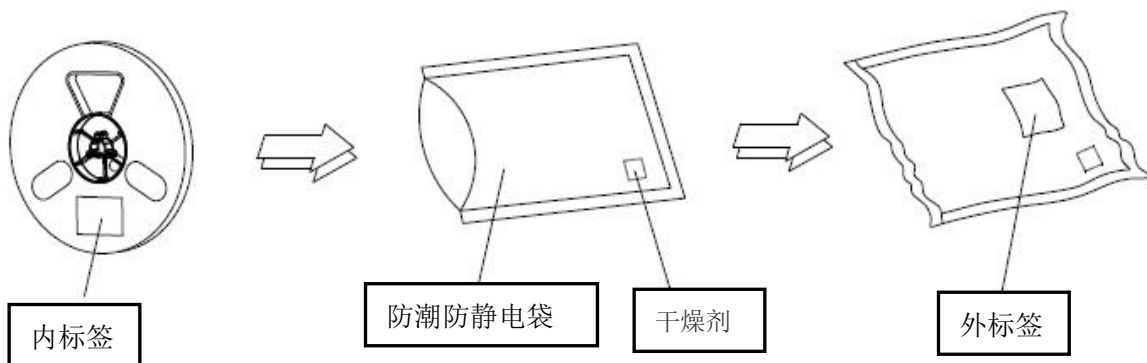


外围电路可以不加任何元器件。

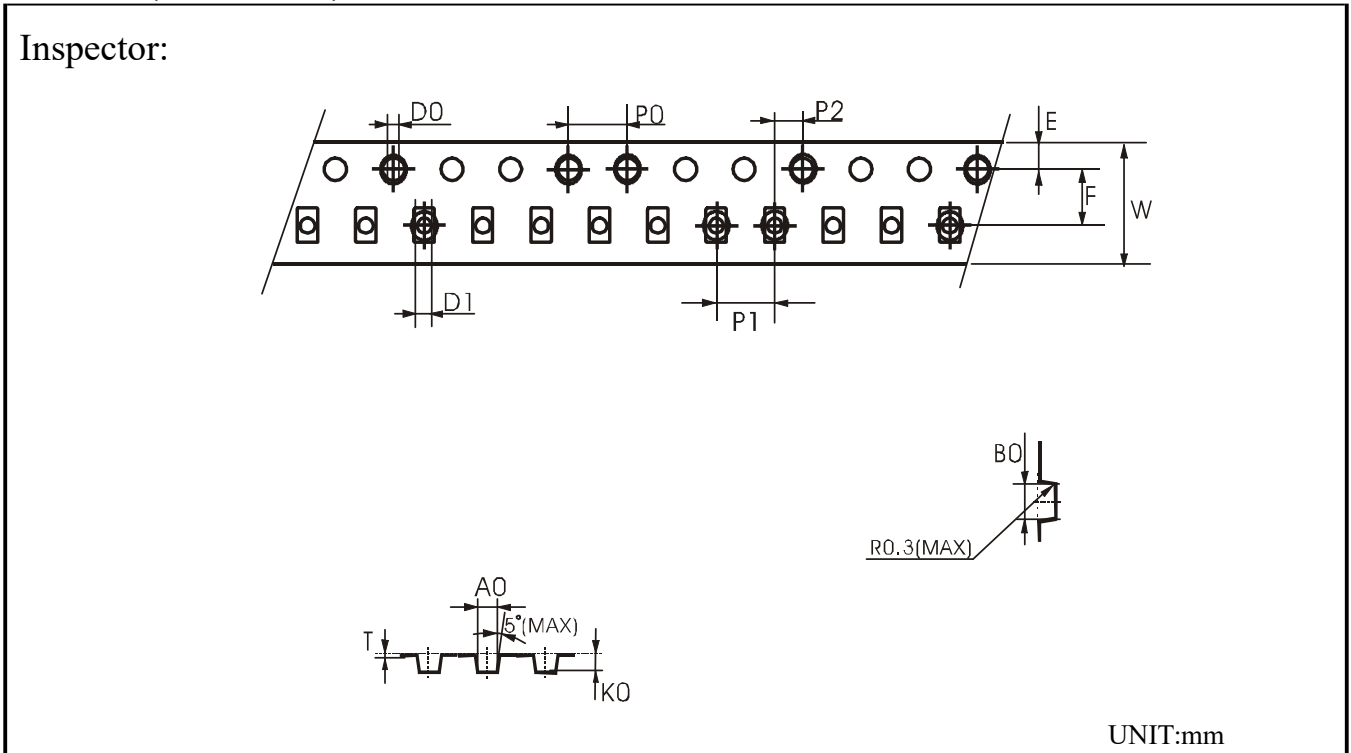
信号接线示意图： 第一颗LED BI接GND



包装方式



载带规格(单位: mm)

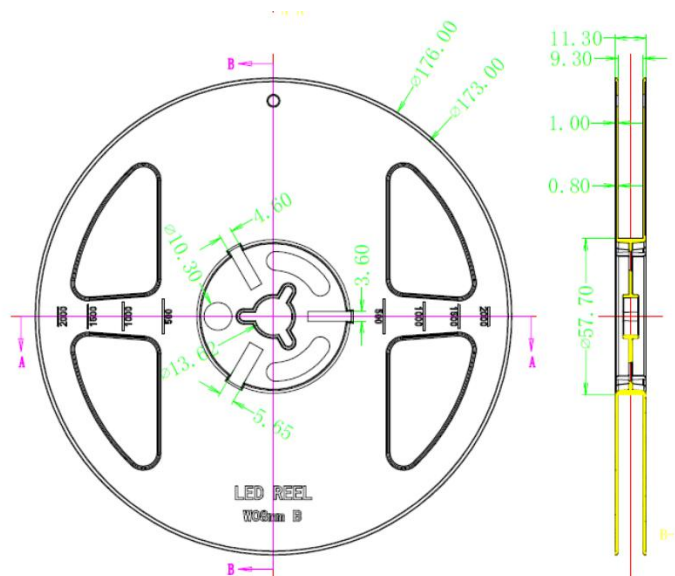


CARRIER TAPES TEST REPORTS

SYMBOL	A0	B0	K0	P0	P1	P2	T	E	F	D0	D1	W
SPEC	2.20	2.40	1.01	4.00	4.00	2.00	0.18	1.75	3.50	1.50	1.00	8.00

卷轴尺寸

单位: mm



表面贴装型 LED 使用注意事项

1. 描述:

通常 LED 也像其它的电子元件一样有着相同的使用方法, 为了让客户更好地使用华彩威的 LED 产品, 请参看下面的 LED 保护预防措施。

2. 注意事项:

2.1. 灰尘与清洁

LED 的表面是采用改性环氧胶封装的, 环氧胶对于 LED 的光学系统和抗老化性能都起到很好的保护作用。环氧胶易粘灰尘, 保持作业环境的洁净。当 LED 表面有一定限度内的尘埃, 也不会影响到发光亮度, 但我们仍应避免尘埃落到 LED 表面。打开包装袋的就优先使用, 安装过 LED 的组件应存放在干净的容器中, 在 LED 表面需要清洁时, 如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使 LED 表面溶解等现象, 不可使用具用溶解性的溶液清洁 LED, 可使用一此异丙基的溶液, 在使用任何清洁溶液之前都应确认是否会对 LED 有溶解作用; 请不要用超声波的方法清洁 LED, 如果产品必须使用超声波, 那么就要评估影响 LED 的一些参数, 如超声波功率, 烘烤的时间和装配的条件等, 在清洁之前必须试运行, 确认是否会影响到 LED。

2.2. 防潮处理

LED 属于湿敏元件, 将 LED 包装在铝膜的袋中是为了避免 LED 在运输和储存时吸收湿气, 在包装袋中放有干燥剂, 以吸收湿气。如果 LED 吸收了水气, 那么在 LED 过回流焊时, 水气就会蒸发而膨胀, 有可能使胶体与支架脱离以及损害 LED 的光学系统。由于这个原因, 防湿包装是为了使包装袋内避免有湿气, 但通常保护时间仅能维持 1~2 个月。此款产品防潮等级 (MSL) 为: **5a**。SMT 时请参照 IPC/JEDECJ-STD-020 规定的材料防潮等级 (MSL) 定义进行 MSL 管控。

防潮等级	包装拆封后车间寿命	
	时间	条件
LEVEL1	无限制	≤30°C/85%RH
LEVEL2	1 年	≤30°C/60%RH
LEVEL2a	4 周	≤30°C/60%RH
LEVEL3	168 小时	≤30°C/60%RH
LEVEL4	72 小时	≤30°C/60%RH
LEVEL5	48 小时	≤30°C/60%RH
LEVEL5a	24 小时	≤30°C/60%RH
LEVEL6	取出即用	≤30°C/60%RH

2.3 SMT 贴片要求:

2.3.1 建议 LED 在 SMT 前拆袋，整卷放入烤箱中进行除湿干燥（70~75℃烘烤 \geq 24H）；

2.3.2 产品从烤箱中取出至高温焊接完成（包含多次回流焊、浸锡、波峰焊、加热维修等高温操作/作业），时间段控制在 24 内（在 T<30℃，RH<60%条件下）；

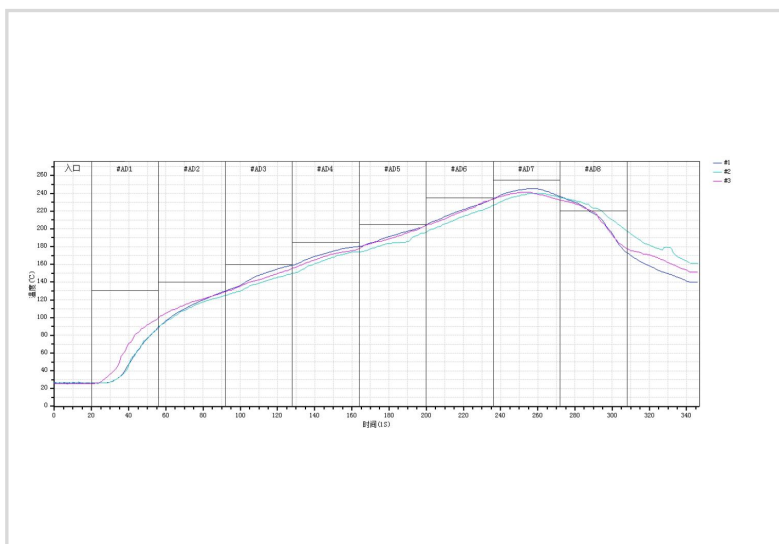
2.3.3 LED 贴片在印刷锡膏后的 PCBA 上，应尽快完成 SMT，建议不超过 1H；

2.3.4 生产剩余、机台抛料、维修用料等散料 LED，若长时间暴露在空气中，不可直接使用，建议进行除湿干燥后再被使用。整卷烘烤：70~75℃* \geq 24H 或 散料烘烤：120℃*4H。

3. 焊接

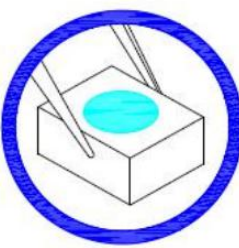
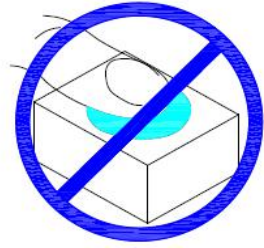
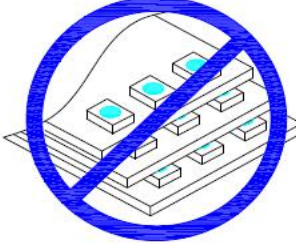

表贴应用 LED 应符合 JEDECJ-STD-020C 标准，作为一般指导原则，建议遵循所用焊锡膏制造商推荐的焊接温度曲线，或使用我司如下推荐的焊接温度曲线。

温度曲线描述	范围
30℃~150℃预热斜率	1~4 °C/s
30℃~150℃预热时间	60~120 s
150℃~200℃恒温斜率	0~3 °C/s
150℃~200℃恒温时间	60~120 s
液相温度	217℃
峰值温度	245℃
回流焊斜率	0~3 °C/s
回流焊时间	45~90 s
降温速率	-4~0 °C/s
室温至峰值温度停留时间	<6 min



注：以上所有温度是指在封装本体焊点表面测得的温度。

4. 产品配装过程注意事项

1. 通过使用适当的工具从材料侧面夹取	2. 不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路	3. 不可将模组材料堆积在一起，它可能会损坏内部电路	4. 不可用在 PH<7 的酸性场所
			

文件更改记录

版本号	状态	修改内容概要	修订日期	修订人	批准人
V1.0	N	新建	20211206	余行辉	尹华平